600584

Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd.

A

ك

كلا 5

جم 12

جم

فى

جـ

/ / /		
/		2013
/		234,962,406 A

FCLGA		Flip Chip Land Grid Array

FC

Bumping UBM Ŵ

هه

Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co.,Ltd.

فخ سم

1

فى Ռ فى

2011 Ռ “ ”

“ ” فى Ռ

Ռ صر تجى ع

Ռ Ռ 2012

فى Ռ

Ռ

فى

يح

FC FC

فى Ռ فى

همم

Ռ

همم

QFII همم

همم

جم تن

جم فى

فى

بخ

كا

ني ير سم

2013 11 28

20

20 20 20

5.32 20 ÷

/

9.5 هد FC

2013 11 27

Ռ

فى جه فى

Ռ فى

Ռ و

LED

;

2005 3,800 2012 8,558.6 2012

59.26%

2005 985.78 2012 2,158.45

AP

2 FC

2008

2010

2006 511.6 2012

1,035.67

I/O

FC I/O

FC FC FC

Yole D éveloppement 2012 FC 200

2018 350 28nm IC DDR

2.5D/3D IC interposer FC

[illegible]

[illegible]MC 22P /MC95 >BDC BT/F2 12 T1322 081 0.02 0.r 0.342186w2 7525 1-40 CD1>4118A7.861-403EE>

1

2012

546 68 صر 471 فى

TSV SiP لم

Cu Pillar Bumping FCBGA 50 m تجى MEMS

جه FC

FC

فى ر فى “

”

2 p p

فى

همه يح

Bumping 8 ″ 12 ″ WLCSP p 3P3M همه BGA

12 ″ 40nm low-k BGA p

جه FC Flip Chip on L/F FCLGA ∩ FCBGA p كا

Bumping Flip Chip

5

116,700 ر p

12,828 هى

2010 2011 2012 2013 9

46.47% 57.50% 62.98% ⊓ 65.58% 9

⊓

جه

⊓

3

2010 2011 2012

2013 1-9 9,032.43 10,015.91

15,725.51 ⊓ 13,486.27

جه

ني

ᵽ

؛

كا

∩

؛

" FC هج 9.5 "

ᵽ سم عج

؛

ني

ˇ ˇ ˇ

كا جم

∩ جم

يخ

جه

هه يج عج

فى

فى عج

يج ؛ يج

جه

ني

16.28% يخ

يخ 5% جه كل

سم

ٿ

Ռ

جه

2008 ؛

ﻋﺠ ﻳﺞ ؛ ﻳﺞ

p̱ ﺻﺮ

ﻋﺠ

Ո p̱ 18

ﻛ ķ DZ ﻋﺠ ħ DZ DZ p̱ DZ * DZ Ǔ Π

Ů ﺣﻢ ﺌﻢ ﻙ ‖

فى

3 ⊓ ⊓

⊓ سه

“

ﷺ

تن

1

îÁ/ÂÅÃCx\4R • 11bdv²¯á k 3 ‡ @ b À

جه ˇ يج

ني Ռ

كلا

1

2

2

2/3

”

ك

3

2010 2012

2012	0.00	1,041.00	-
2011	0.00	6,731.71	-
2010	5,118.80	20,771.21	24.64%
ك			**9,514.64**
ك			**53.80%**

“ ”

يج

Ռ جه

Ռ يج هه

هى

Ռ

جه فى

هى Ռ

Ռ جه

Ռ

هى 2015- 2013

1 جه

2 جه

4 جم

2

 هى نعي

1 هى

جم ( )